

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于郑隆芯创拟对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **对外投资概述：**上海郑隆芯创微电子有限公司（以下简称“郑隆芯创”）计划在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HITS 先进封装研发产业化项目”（以下简称“本项目”），投资总额预计不低于人民币 75 亿元（最终以项目建设实际投资金额为准）。郑隆芯创系合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）与关联方共同投资设立合资公司合肥晶瑞旺电子有限公司（以下简称“晶瑞旺”）之全资子公司，属于汇成股份合并报表范围内公司。

- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：

本次对外投资事项已于 2026 年 7 月 13 日获得公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，但尚需提交公司股东会审议批准。公司董事会同意将本次对外投资事项提交股东会审议，并提请股东会授权郑隆芯创管理层及其授权人士就项目落地与相关政府部门开展沟通洽谈，并适时签署与项目投资和建设相关的协议文件。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本次对外投资的资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金，资金筹措存在不确定性，本项目在投资运营过程中，会对公司现金流造成一定的压力，且若在项目投资建设过程中，资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化，公司可能存在较大的资金筹措压力及现金流风险。公司将

统筹资金安排，合理确定郑隆芯创资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

2、本项目整体建设工期约 42 个月，周期较长，项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险，设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性，在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。

3、本项目尚需完成协议签署、土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批；若遇政策调整、审批受阻或评审未通过等情形，项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。

4、产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性，可能导致项目投资计划推进不及预期、投资收益无法实现。

5、本项目投资总额等数值均为计划数和预估数，实际执行情况可能与预期存在差距，未来市场情况的变化也将对项目投资的实施造成不确定性影响。

6、本项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、业务发展规划等因素综合确定。由于行业发展较快，在本项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩等市场环境的不利变化，郑隆芯创新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本项目的经济效益。

7、本项目实施过程中，将产生较大金额的折旧摊销和其他费用支出，如果本项目无法实现预期效益，则前述折旧摊销和费用等将对公司未来经营业绩产生重大不利影响，公司净利润可能因此出现大额亏损。

公司将密切跟进项目各环节进展，严格把控风险，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次投资概况

1、基本情况介绍

公司拟充分利用核心工艺技术积累，协同具备丰富产业经验的技术团队，共同拓展 HITS 先进封装工艺平台，以满足客户更高集成度、更高性能及更高可靠性的封装及测试服务需求，把握人工智能（AI）及高性能计算（HPC）领域的市场增长机遇。为此，公司与关联方共同出资设立合资公司，合资公司设立后收购上海郑隆芯创微电子有限公司 100%股权。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司及股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

近日，合资公司晶瑞旺已完成设立并收购郑隆芯创 100%股权，郑隆芯创将作为晶瑞旺 HITS 先进封装研发总部，承担技术工艺研发及业务导入的重要功能。

郑隆芯创拟在上海市嘉定区南翔镇内东部工业园区 JDC2-0401 单元 01-08 地块投资建设“HITS 先进封装研发产业化项目”，本项目投资总额预计不低于人民币 75 亿元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资项目名称	HITS 先进封装研发产业化项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额： <u>不低于 75 亿元（以实际投入金额为准）</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☒ 其他： <u>自筹资金</u>

	☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

本次对外投资事项已于 2026 年 7 月 13 日获得公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，但尚需提交公司股东会审议批准。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司合并报表范围内子公司晶瑞旺之全资子公司郑隆芯创计划在上海市嘉定区南翔镇内东部工业园区 JDC2-0401 单元 01-08 地块投资建设“HITS 先进封装研发产业化项目”。

（二）投资标的的信息

1、项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	HITS 先进封装研发产业化项目
项目主要内容	HITS 先进封装技术旨在利用基于有机中介层的架构，实现多个芯片在单一封装内的晶圆级平面整合，从而提供更高的性能、更小的尺寸及更强的散热效率。
建设地点	上海市嘉定区南翔镇内东部工业园区 JDC2-0401 单元 01-08 地块
项目总投资金额（万元）	不低于 750,000.00（以实际投入金额为准）

上市公司投资金额（万元）	/
项目建设期（月）	42 个月
预计投资收益率	不适用
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

2、各主要投资方出资情况

本项目实施主体为郑隆芯创，无其他投资方。

3、项目目前进展情况

本项目仍处于前期筹备阶段，郑隆芯创将尽快推进协议签署及后续落地实施等工作。

4、项目市场定位及可行性分析

AI 和 HPC 相关领域芯片对高速互连等前沿封装技术的市场需求是全球先进封装及测试行业关键驱动力之一，为把握先进封装领域市场增长机遇，公司计划利用核心工艺技术以及团队拓展专属研发平台 HITS，以开发公司下一代先进封装及测试解决方案，重点关注超窄间距凸块键合、超细线路互连高速芯片、超大尺寸芯片系统整合封装、高密度互连及精细间距再布线层等关键技术节点。

本项目定位为公司 HITS 先进封装研发总部，承担技术工艺研发及业务导入的重要功能，预期未来能够为客户在高端移动设备、人工智能伺服器及边缘人工智能应用等领域提供更高集成度、更高性能及更高可靠性的封装及测试服务。

（三）出资方式及相关情况

郑隆芯创出资方式为货币出资，资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金，不涉及上市公司既有募集资金。

三、对外投资合同的主要内容

对外投资合同尚未签订。为抓住市场机会，高效推进项目建设，董事会提请股东会授权郑隆芯创管理层及其授权人士就项目落地与相关政府部门开展沟通洽谈，并适时签署与项目投资和建设相关的协议文件。

四、对外投资对上市公司的影响

HITS 先进封装研发产业化项目的投资建设有助于公司拓宽技术边界、完善公司先进封装产业和技术布局，把握 AI 及 HPC 领域的市场增长机遇，进一步巩固公司在先进封装领域的市场地位与综合竞争力。项目目前尚处于前期准备阶段，预计对汇成股份 2026 年度经营业绩不会产生重大影响。项目达产后，公司有望形成新的业绩增长点，预计届时公司盈利能力与资产回报率将会得到提升。但在项目投资建设和运营过程中，产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性，可能导致项目投资计划推进不及预期、投资收益无法实现。

五、对外投资的风险提示

（一）本次对外投资的资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金，资金筹措存在不确定性，本项目在投资运营过程中，会对公司现金流造成一定的压力，且若在项目投资建设过程中，资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化，公司可能存在较大的资金筹措压力及现金流风险。公司将统筹资金安排，合理确定郑隆芯创资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

（二）本项目整体建设工期约 42 个月，周期较长，项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险，设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性，在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。

（三）本项目尚需完成协议签署、土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批；若遇政策调整、审批受阻或评审未通过等情形，项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（四）产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研

发等内外部因素均存在不确定性，可能导致项目投资计划推进不及预期、投资收益无法实现。

（五）本项目投资总额等数值均为计划数和预估数，实际执行情况可能与预期存在差距，未来市场情况的变化也将对项目投资的实施造成不确定性影响。

（六）本项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、业务发展规划等因素综合确定。由于行业发展较快，在本项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩等市场环境的不利变化，郑隆芯创新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本项目的经济效益。

（七）本项目实施过程中，将产生较大金额的折旧摊销和其他费用支出，如果本项目无法实现预期效益，则前述折旧摊销和费用等将对公司未来经营业绩产生重大不利影响，公司净利润可能因此出现大额亏损。

公司将密切跟进项目各环节进展，严格把控风险，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日